



(2000円)

特許庁長官 殿

(特許法第85条に於て)
の規定による特許出願

昭和48年11月7日

① 日本国特許庁

公開特許公報

① 特開昭 49-102726

④ 公開日 昭49.(1974) 9 27

② 特願昭 48-11724

② 出願日 昭48.(1973) / . 29

審査請求 有 (全3頁)

庁内整理番号

⑤ 日本分類

6660 48

24A03

6683 37

24D01

- 1 発明の名称 電圧による接層層の形成方法
- 2 特許請求の範囲に記載された発明 2
- 3 発明者 出願人と同じ
- 4 特許出願人

住所 川崎市高津区宮崎1丁目12番地5
氏名 藤 野 昭

5 所付書類の目録

- (1) 願書原本 1 通
- (2) 明細書 1 通
- (3) 図面五枚表裏 1 通
- (4) 図面 1 通



別 紙

方法。

- 1 発明の名称 電圧による接層層の形成方法

2 特許請求の範囲

1. 導電性表面に高分子またはそれに導電性材料を塗布した材料を電圧作用によって処理させた形成状態の絶縁層に、あるいはさらにその上に通常の絶縁層を塗布して成る複合層に、所定の接層層を形成させたものを前記複合層を圧着固化させる接層処理の方法。
2. 導電性表面に高分子またはそれに導電性材料を塗布した材料を電圧作用によって処理させた形成状態の絶縁層に、あるいはさらに通常の絶縁層を塗布して成る複合層に、圧電素子、半導体素子および絶縁素子のごとき所定の素子を配置させ、しかも前記複合層を圧着固化させる接層処理の方法。

3 発明の詳細な説明

一般に全基向あるいは極めて小さな部曲の食肉片を他の絶縁性物質の表面に接合するには、合成樹脂層等で作られた通常の接層剤を接層物質に何らかの方法にて直接塗布し乾燥させて両者の接合をなすしめる。しかし接層剤そのものと直接接合性はよくとも食肉等に対する接層効果は通常きわめて弱く、また安定性も劣る。特に少量の接層剤しか使えないような場合には堅固な接層性を得ることが困難である。本発明の方法は食肉その他の導電性表面において電圧作用をとるによって高分子等を溶解させる電圧接層法によって、溶解した樹脂あるいはこれに原料を配合したものが極めて微細かつ強固に食肉表面に対して接合されることができ、これを接合介在層(または中間層)として利用したものである。

すなわち接層層を接合とし、他の部の接合

以上に示した実施例からもわかるように本発明の方法は、極めて広い利用面がある。そして結合材料の中心導性体、導体、半導体あるいは絶縁体、また電子材料としての機能をもつ物質の微粒子と、電場磁場溶液中に存在させて電離することにより、その電気的相互作用した状態を形成することができる。

例えば上に述べた実施例のほかに、マイクロ波粒子の電気的運動と溶液体の機械的運動とを絶えずよく混合するためのトランスジューサあるいは複合かつ小型の電気磁場の発生部などによって効率的な手段となり、安定性にも寄与方法である。

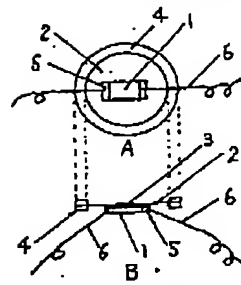
4. 図面の簡単な説明

第1図Aは金箔電極間に半導体薄膜を貼着した上図面であり、第1図Bはその側面図を示したものである。

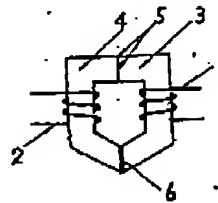
そして第2図は電気回路の概略を示す図面である。

特許出願人 松下 電 器

特開 昭49-102726 (5)



第1図



第2図

CATIONIC ELECTRODEPOSITION PROCESS AND COATING COMPOSITION FOR CATIONIC ELECTRODEPOSITION

Patent Number: EP0854207
 Publication date: 1998-07-22
 Inventor(s): KAWAKAMI ICHIRO (JP); SAKAMOTO HIROYUKI (JP); HORI HITOSHI (JP); SAITO TAKAO (JP); NISHIO MASAHIRO (JP)
 Applicant(s): NIPPON PAINT CO LTD (JP)
 Requested Patent: ☐ EP0854207, A4, B1
 Application Number: EP19970932983 19970723
 Priority Number (s): WO1997JP02537 19970723; JP19960213019 19960723; JP19960327832 19961122
 IPC Classification: C25D13/00; C09D5/44
 EC Classification: C09D5/44
 Equivalents: AU3633597, ☐ AU709714, CA2232638, CN1118590C, CN1198192, CN1485378, ☐ DE69727656D, ☐ DE69727656T, JP3259274B2, TW426718, ☐ US6106684, ☐ WO9803701
 Cited Documents:

Abstract

A cation electrodeposition coating process and cation electrodeposition coating composition that have a sufficient throwing power are provided. A process for cationic electrodeposition coating which comprises the steps of: (1) immersing a substrate in a cationic electrodeposition coating composition; (2) applying a voltage between an anode and said substrate, which serves as a cathode, to thereby cause coat film deposition; and (3) further applying a voltage to the coat film deposited so as to increase electric resistance per unit volume of said coat film, wherein, in said step (3), coat films are deposited at those sites of the substrate where coat films have not yet been deposited, said cationic electrodeposition coating composition having a time point when the electric resistance per unit volume of the coat film deposited increases in the course of electrodeposition under constant-current conditions.

Data supplied from the esp@cenet database - 12